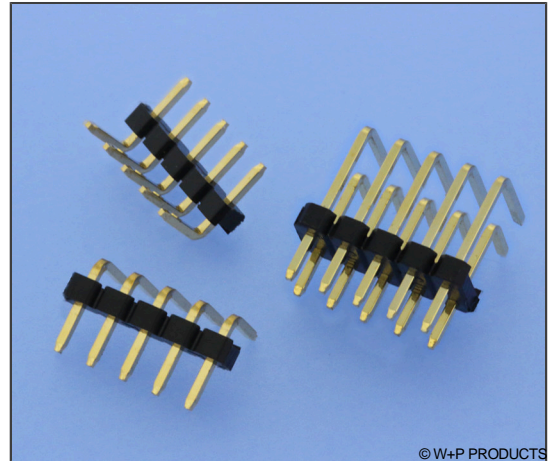


# 46-933 / 46-934

## Stiftheisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig – 1,7mm Isolierkörper Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row – 1.7mm Body

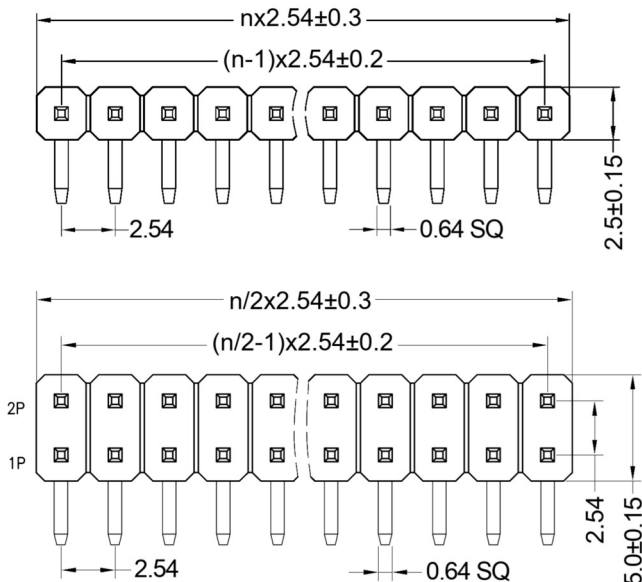
### Technische Daten / Technical Data

|  |  |
|--|--|
| Isolierkörper<br><i>Insulator</i>                            | Thermoplast, nach UL94 V-0<br><i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>   |
| Kontaktmaterial<br><i>Contact Material</i>                   | Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung<br><i>0.64mm square pin, copper alloy</i>                                      |
| Kontaktoberfläche<br><i>Contact Surface</i>                  | Au über Ni<br><i>Au over Ni</i>  |
| RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c<br><i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i> | keine<br><i>none</i>   |
| Durchgangswiderstand<br><i>Contact Resistance</i>            | 20 mΩ max.<br><i>20 mΩ max.</i>  |
| Isolationswiderstand<br><i>Insulation Resistance</i>         | 1000 MΩ min.<br><i>1000 MΩ min.</i>  |
| Spannungsfestigkeit<br><i>Test Voltage</i>                   | 1000 V AC/DC<br><i>1000 V AC/DC</i>  |
| Nennstrom<br><i>Current Rating</i>                           | 3.0 A<br><i>3.0 A</i>  |
| Temperaturbereich<br><i>Temperature Range</i>                | -40 °C ... +105 °C<br><i>-40 °C ... +105 °C</i>  |
| Verarbeitung<br><i>Processing</i>                            | 230 °C für 30-60 Sekunden<br>(260 °C für 10 Sekunden)<br><i>230 °C for 30-60 seconds<br/>(260 °C for 10 seconds)</i> |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
153 154 46-157 46-159 46-160 / 46-162 46-624 etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen.  
*Please note tech. information for PCB layouts and detailed drawings.*

### Series\*

**46-933**

46-933 Einreihig  
*Single row*  
46-934 Zweireihig  
*Double row*

### Dimensions\*

**15**

12 B=3.5 C=3.3mm  
13 B=4.8 C=3.3mm  
14 B=6.1 C=3.3mm  
15 B=6.9 C=3.3mm  
16 B=9.9 C=3.3mm  
17 B=12.0 C=3.3mm  
18 B=13.8 C=3.3mm  
19 B=15.0 C=3.3mm  
20 B=17.1 C=3.3mm

### Contacts\*

**010**

001-020 Einreihig  
*Single row*  
004-060 Zweireihig  
*Double row*

### Plating

**00**

00 Vergoldet  
*Gold plated*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

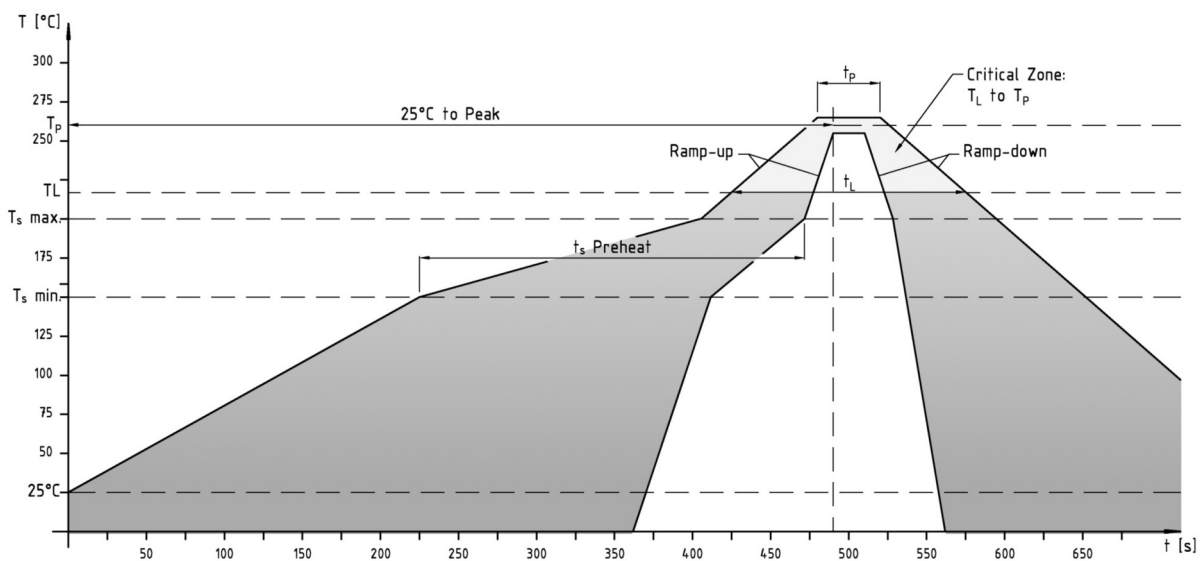
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C                          |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C                          |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s                       |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | untere Temperaturangabe [°C]    |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s                   |
| Höchsttemperatur $T_P$               | obere Temperaturangabe [°C]     |
| Dauer Höchsttemperatur               | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                        |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m                         |

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

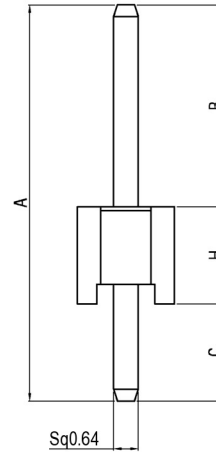
Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values              |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C                  |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C                  |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s               |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | Lower Temperature [°C]  |
| Duration above $T_L$                 | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s           |
| Peak Temperature $T_P$               | Upper Temperature [°C]  |
| Duration Peak Temperature            | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min               |



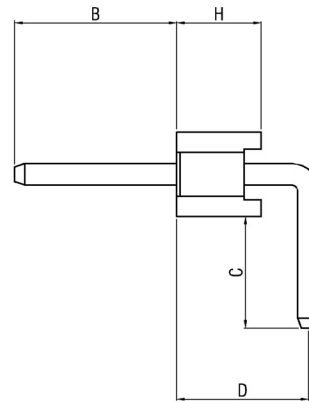
## Gerade Stiftheiten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height



## Gewinkelte Stiftheiten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height



## PCB Layouts

